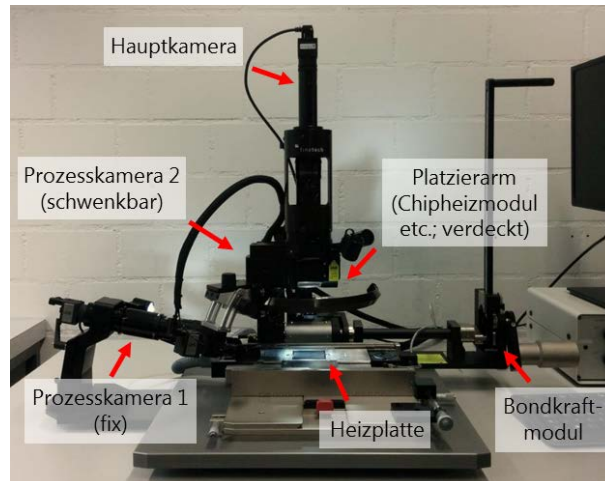


Manueller Flip Chip Bonder (Fineplacer® pico ma)

Empa Abteilung 202, Fügetechnologie und Korrosion

Typische Einsatzbereiche

- Entwicklung neuer Lötverfahren
- Prozessentwicklung (Thermokompression, thermosonic bonding, etc.) als Vorstufe für automatisierte Prozesse

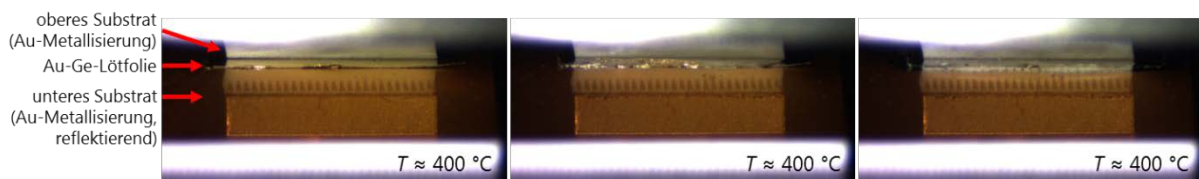


manueller Flip Chip Bonder

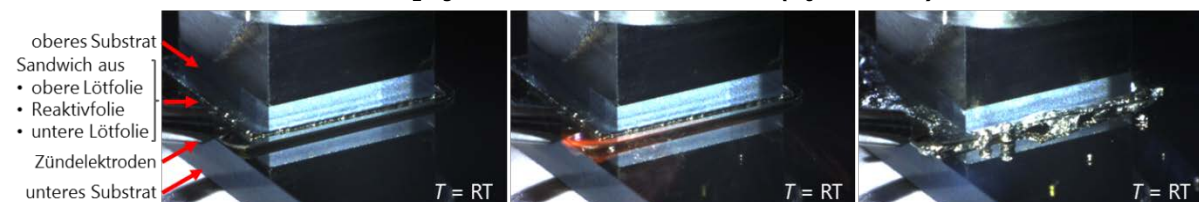
Kenndaten

- Laterale Genauigkeit bis zu 5 μm
- Substrat-Heizplatte & Chip-Heizmodul (je bis zu 480 $^{\circ}\text{C}$ mit max. 20 K/s)
- Bondkraftmodul (max. 100 N)
- Ultraschallmodul
- Schutzgasatmosphäre
- Mehrere Prozesskameras

Anwendungsbeispiele



Löten von Al_2O_3 mit Au-Ge-Lot bei 400 $^{\circ}\text{C}$ ($T_e = 361$ $^{\circ}\text{C}$)



Fügen von Borosilikatglas mit reaktiven Folien bei Raumtemperatur

Kontakt

Bastian Rheingans
Mail: bastian.rheingans@empa.ch
Telefon: +41 58 765 4371

Jolanta Janczak-Rusch
Mail: jolanta.janczak@empa.ch
Telefon: +41 58 765 4529

Lars Jeurgens
Mail: lars.jeurgens@empa.ch
Telefon: +41 58 765 4053